

深圳市江波龙电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	东方证券、鹏华基金、Willing Capital
时间	2026年2月25日(周三) 15:00-16:00
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座2301
上市公司接待人员姓名	投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、如何看待公司主控芯片的技术能力？公司主控芯片整体的应用规划？</p> <p>答：公司目前已推出了应用于 UFS、eMMC、SD 卡、高端 USB 等领域的多款主控芯片。公司主控芯片采用领先于主流产品的头部 Foundry 工艺，采用自研核心 IP，搭配公司自研固件算法，使得公司各类存储产品具有明显的性能和功耗优势。在旗舰存储产品上，全球目前仅有包括公司在内的少数企业具备在芯片层面开发 UFS4.1 产品的能力，而搭载公司自研主控的 UFS4.1 产品在制程、读写速度以及稳定性上优于市场可比产品。</p> <p>截至 2025 年三季度末，公司自研的多款主控芯片累计部署量已突破 1 亿颗。基于领先的主控芯片能力，公司已与多家晶圆原厂及头部智能终端设备厂商构建了深度合作关 系，搭载公司自研主控芯片的 UFS4.1 产品正在批量出货前夕。</p> <p>2、mSSD 相较于传统 SSD 产品的优势在哪？mSSD 产品有多高的进入壁垒？</p> <p>答：公司 mSSD 作为传统 SMT 工艺 SSD 的升级形态，通过 Wafer 级系统级封装（SiP），实现轻薄化、紧凑化，在满足存储协议低功耗要求、大幅降低空间占用的同时，保持了与传统 SSD 相当的性能水平，并具备更优异的物理特性和综合成本优势。</p> <p>mSSD 作为一项重大的产品创新，市场前景广阔。围绕该产品，公司已经构建了丰富的知识产权布局，并基于自主封测实力，实现了技术从研发验证向实际商业落地的顺利转化，mSSD 产品正在多家头部 PC 厂商加快导入。</p> <p>3、如何看待 SOCAMM、CXL、HBF 等新型存储产品的应用？公司在新型存储产品上有哪些技术储备？</p> <p>答：公司作为全球领先的半导体存储品牌企业，持续关</p>
---------------------------	---

	<p>注存储市场技术前沿动态，已发布 MRDIMM、CXL2.0 内存拓展模块、SOCAMM2 等多款前沿高性能存储产品，并将根据市场需求进行产品布局和技术创新。</p> <p>4、如何看待本轮周期的持续性？</p> <p>答：结合第三方机构信息来看，随着 AI 推理在系统架构与资源调度等方面的结构性变化，特别是键值缓存（KV Cache）与检索增强生成（RAG）技术的应用，AI 推理对存储的容量需求显著扩大，叠加 AI 基础设施快速扩张与 HDD 供应短缺，共同推动存储需求爆发式增长；受制于产能建设周期的滞后性，存储原厂资本开支回升对短期位元产出的增量贡献也将较为有限。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>